



### QS-SÄGESCHNITT AN LEITERPLATTEN

Ein spezialverzahntes Sägeblatt mit Spiegelhohlschliff ermöglicht in Verbindung mit der *DIADISC* Labor-Trennsäge Typ 4200 von *MUTRONIC* besonders glatte Schnitte mit perfekten Kanten ohne „Ausfransungen“ wie sie für die Qualitätskontrolle von Leiterplattenlayern und Durchkontaktierungen erforderlich sind.

Die Schnitte können trocken oder nass erfolgen. Eine Micro-Sprühnebel-einrichtung sorgt für die minimale und gleichmäßige Benetzung des Sägeblattes mit Wasser, sodass Gratbildung und Erhitzung vermieden werden.

Mittels *DIATool*-Schnellwechselsystem lassen sich die Sägeblätter für den Grob- und den QS-Feinschnitt sekundenschnell und sicher tauschen.

MUTRONIC GmbH & Co.KG  
Sankt Urban Straße 20  
87669 RIEDEN  
Telefon: 0049/8362-930 900  
e-mai: [info@mutronic.de](mailto:info@mutronic.de)

Telefax: 0049/8362-930 90-49  
Internet: [www.mutronic.de](http://www.mutronic.de)